



ЭЛЕКТРОН-МАШ

Каталог металлокерамических корпусов для изделий СВЧ-электроники

Москва

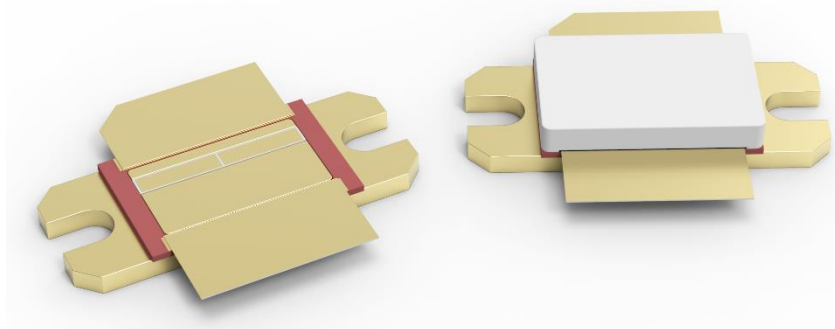
2023



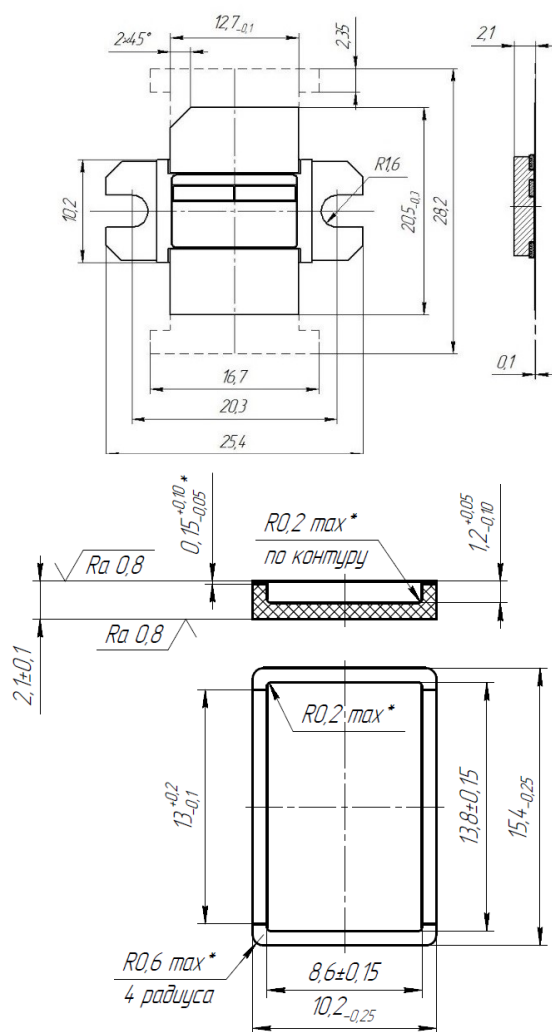
Корпуса для мощных СВЧ транзисторов.....	3
Корпус ТЛВШ.432269.001 с диапазоном частот до 4 ГГц.....	3
Корпус ТЛВШ.432269.003 с диапазоном частот до 12 ГГц.....	4
Корпус ТЛВШ.432269.007 с диапазоном частот до 18 ГГц.....	5
Корпус ТЛВШ.432269.008 с диапазоном частот до 4 ГГц.....	6
Корпус ТЛВШ.432269.009 с диапазоном частот до 4 ГГц.....	7
Корпус ТЛВШ.432269.010 с диапазоном частот до 4 ГГц.....	8
Корпус ТЛВШ.432269.012 с диапазоном частот до 6 ГГц.....	9
Корпус ТЛВШ.432269.013 с диапазоном частот до 6 ГГц.....	10
Корпус ТЛВШ.432269.014 с диапазоном частот до 4 ГГц.....	11
Корпуса для мощных СВЧ МИС и ГИС.....	12
Корпус ТЛВШ.301175.004 с диапазоном частот до 7 ГГц.....	12
Корпус ТЛВШ.301175.005 с диапазоном частот до 17 ГГц.....	13
Корпус ТЛВШ.301175.006 с диапазоном частот до 18 ГГц.....	14
Корпус ТЛВШ.301175.007 с диапазоном частот до 18 ГГц.....	15
Корпус ТЛВШ.301175.008 с диапазоном частот до 20 ГГц.....	16
Корпус ТЛВШ.301175.009 с диапазоном частот до 22 ГГц.....	17
Корпус ТЛВШ.301175.010 с диапазоном частот до 20 ГГц.....	18
Корпус ТЛВШ.432269.011 с диапазоном частот до 18 ГГц.....	19

Корпуса для мощных СВЧ транзисторов

Корпус ТЛВШ.432269.001 с диапазоном частот до 4 ГГц



Габаритный чертеж



Технические характеристики

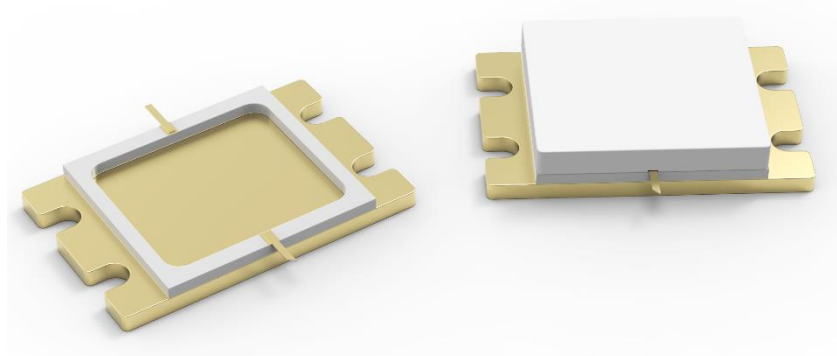
Количество выводов, шт.	2
Шаг выводов, мм	-
Размеры основания, мм	25,4×10,2
Высота корпуса с установленной крышкой, мм, не более	5,0
Размер монтажной площадки, мм	12,1×1,4
Покрытие	НЗ.Зл4
Метод крепления кристалла в корпусе	клей, пайка
Метод герметизации	клей
Показатель герметичности корпуса, Па·см ³ /с, не более	6,65·10 ⁻³
Диапазон рабочих частот, ГГц, КСВ≤1,75	0,01..4,0

Варианты исполнения:

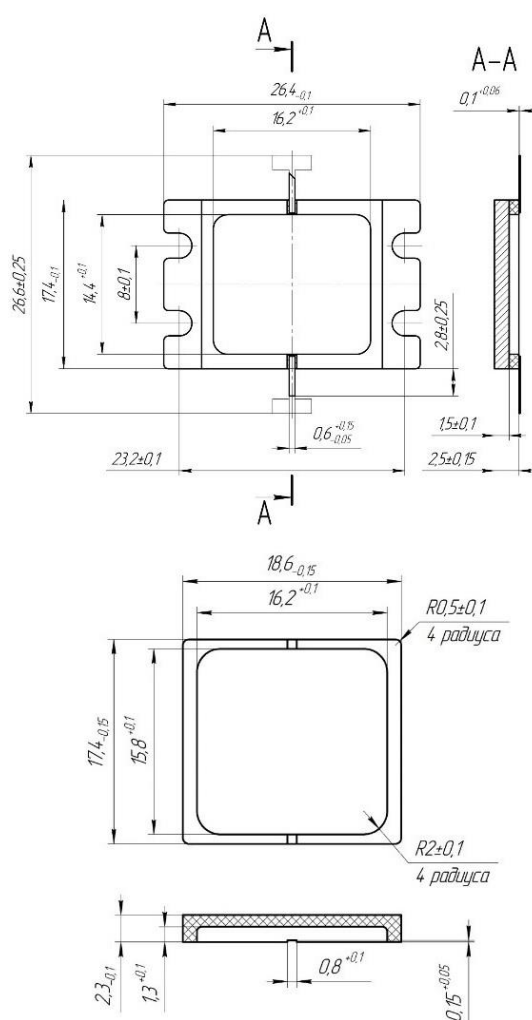
Корпус ТЛВШ.432269.001– со вставкой из ALN-230 керамики;

Корпус ТЛВШ.432269.001-01 – со вставкой из ВеО керамики.

Корпус ТЛВШ.432269.003 с диапазоном частот до 12 ГГц



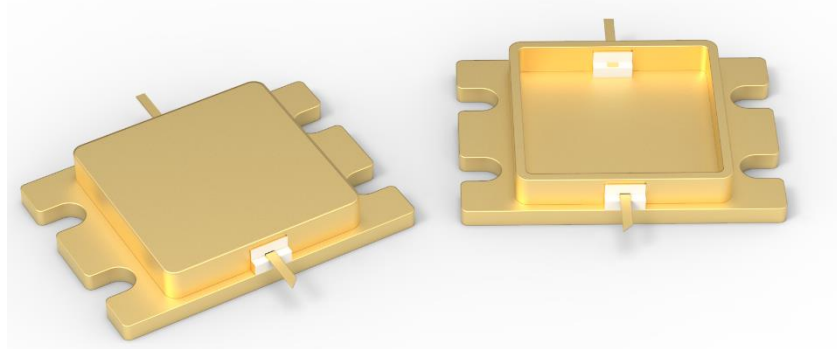
Габаритный чертеж



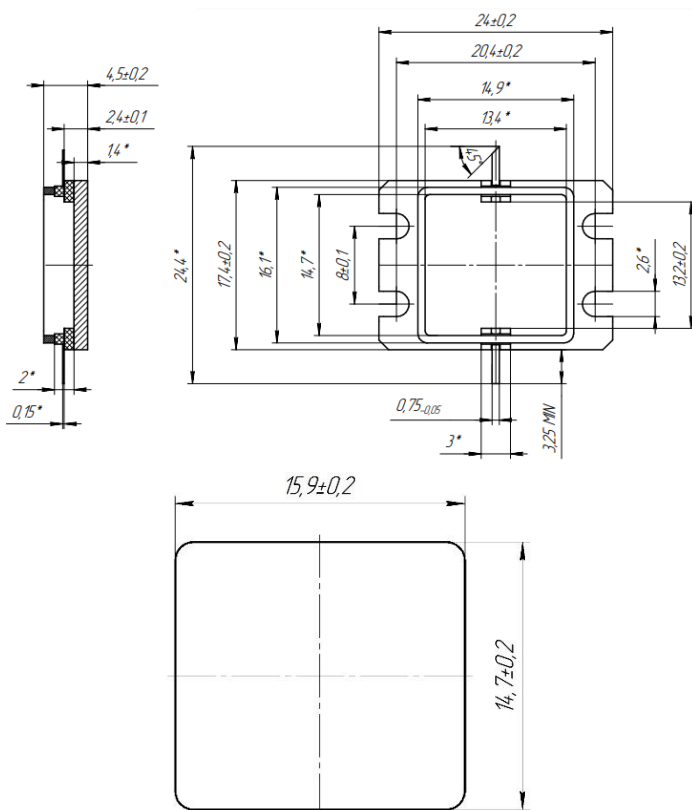
Технические характеристики

Количество выводов, шт.	2
Шаг выводов, мм	-
Размеры основания, мм	26,4×17,4
Высота корпуса с установленной крышкой, мм, не более	5,0
Размер монтажной площадки, мм	16,2×14,4
Покрывтие	НЗ.Зл4
Метод крепления кристалла в корпусе	клей, пайка
Метод герметизации	клей
Показатель герметичности корпуса, Па·см ³ /с, не более	$6,65 \cdot 10^{-3}$
Диапазон рабочих частот, ГГц, КСВ≤1,75	0,01..12,0

Корпус ТЛВШ.432269.007 с диапазоном частот до 18 ГГц



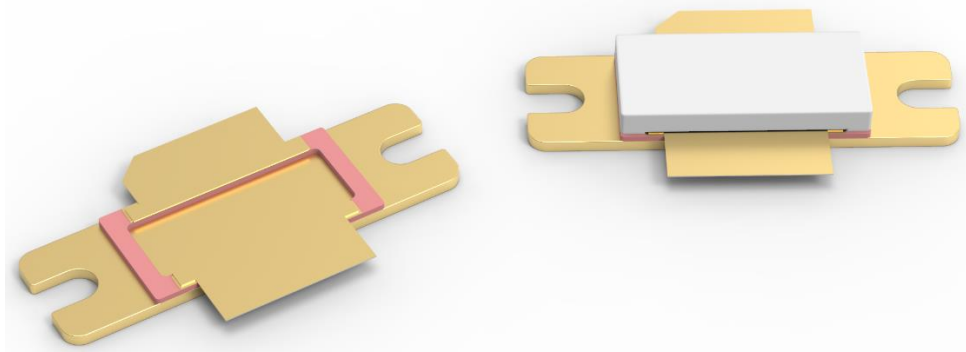
Габаритный чертеж



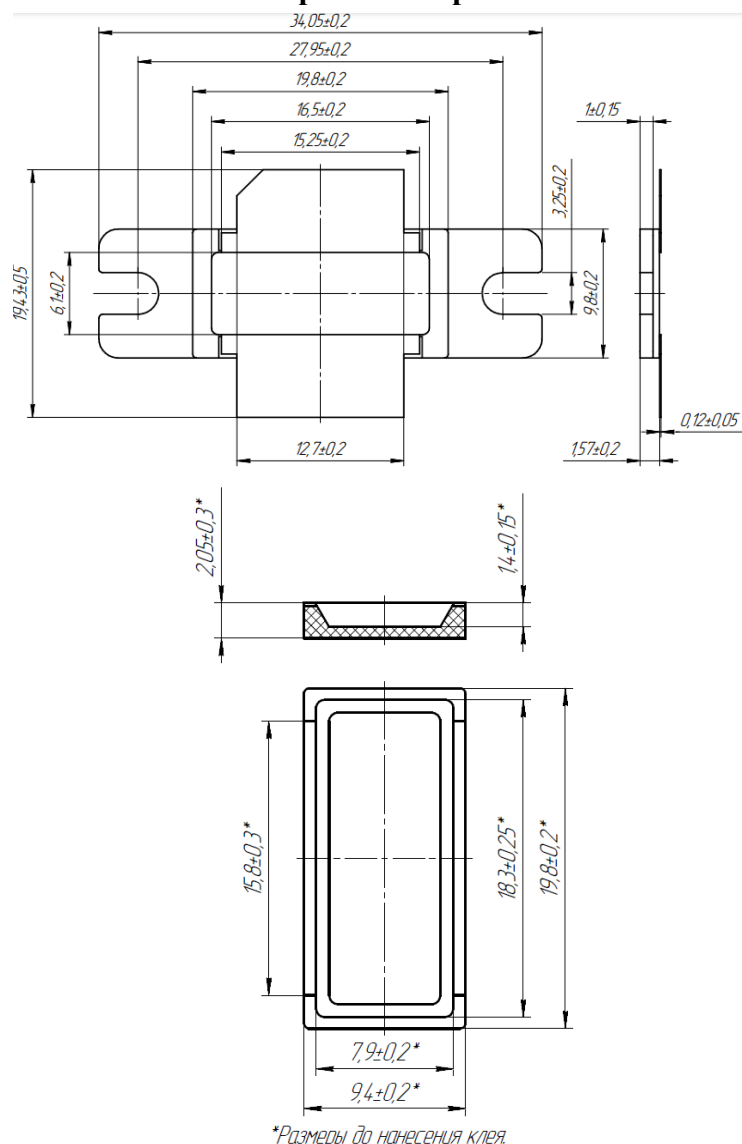
Технические характеристики

Количество выводов, шт.	2
Шаг выводов, мм	-
Размеры основания, мм	24,0×17,4
Высота корпуса с установленной крышкой, мм, не более	5,0
Размер монтажной площадки, мм	13,4×14,7
Покрытие	H3.3л2,5
Метод крепления кристалла в корпусе	клей, пайка
Метод герметизации	ШРС
Показатель герметичности корпуса, Па·см ³ /с, не более	6,65·10 ⁻³
Диапазон рабочих частот, ГГц, КСВ≤1,75	0,01..18,0

Корпус ТЛВШ.432269.008 с диапазоном частот до 4 ГГц



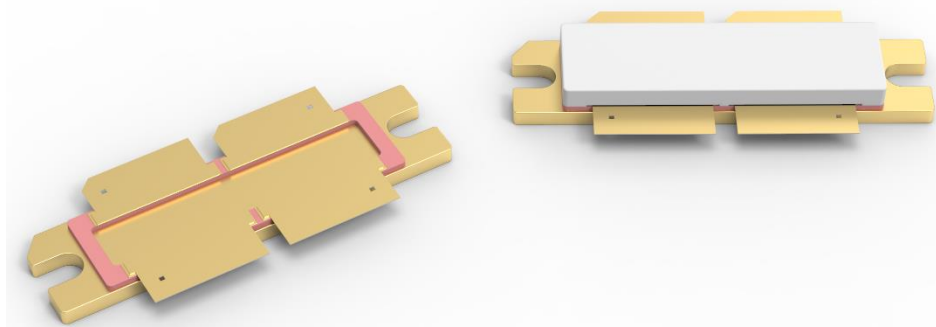
Габаритный чертеж



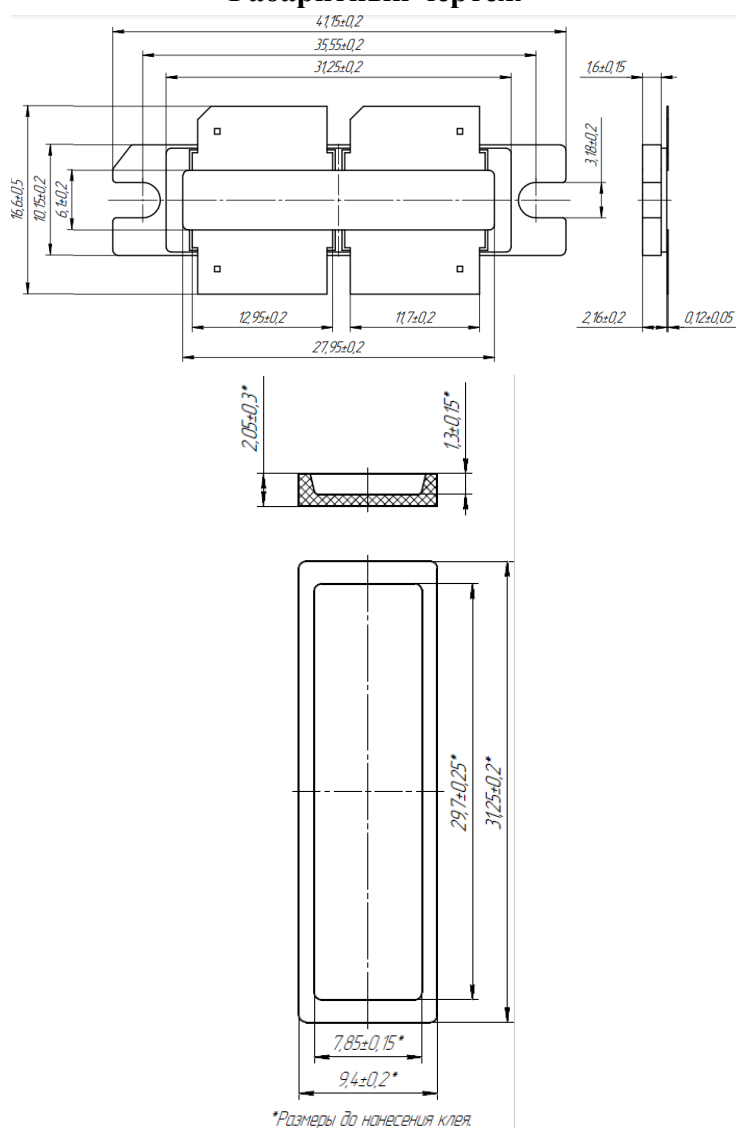
Технические характеристики

Количество выводов, шт.	2
Шаг выводов, мм	-
Размеры основания, мм	34,0×9,8
Высота корпуса с установленной крышкой, мм, не более	4,5
Размер монтажной площадки, мм	16,5×6,1
Покрытие	H3.3л3,5
Метод крепления кристалла в корпусе	клей, пайка
Метод герметизации	клей
Показатель герметичности корпуса, Па·см ³ /с, не более	$6,65 \cdot 10^{-3}$
Диапазон рабочих частот, ГГц, KCB≤1,75	0,01..4,0

Корпус ТЛВШ.432269.009 с диапазоном частот до 4 ГГц



Габаритный чертеж



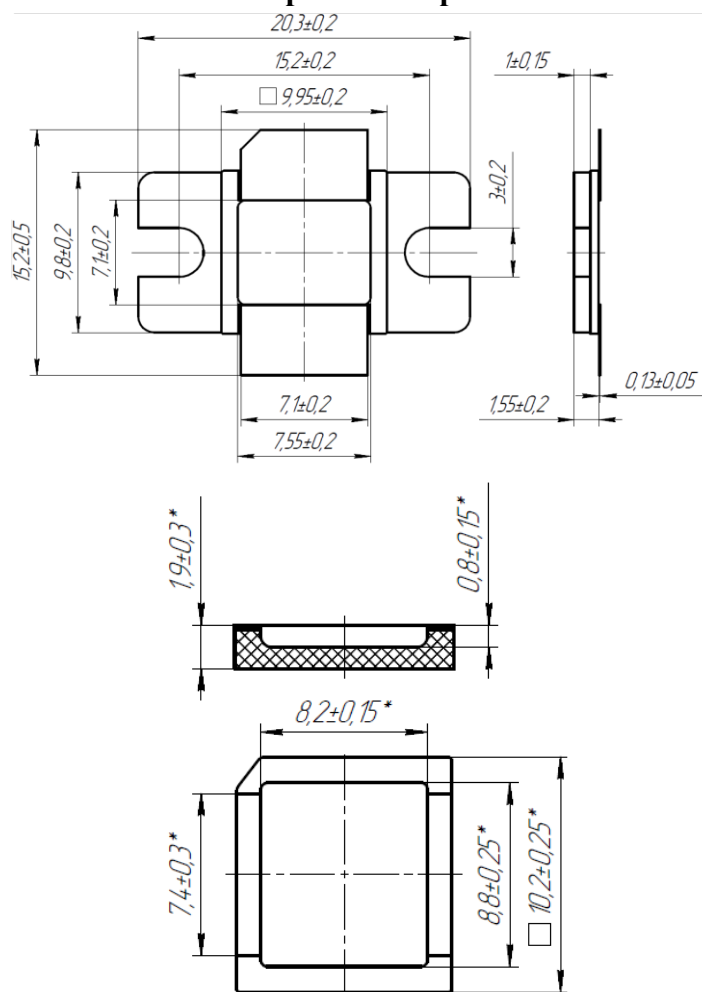
Технические характеристики

Количество выводов, шт.	2
Шаг выводов, мм	-
Размеры основания, мм	41,1×10,1
Высота корпуса с установленной крышкой, мм, не более	4,8
Размер монтажной площадки, мм	27,9×6,1
Покрытие	H3.3л2,5
Метод крепления кристалла в корпусе	клей, пайка
Метод герметизации	клей
Показатель герметичности корпуса, Па·см ³ /с, не более	$6,65 \cdot 10^{-3}$
Диапазон рабочих частот, ГГц, KCB≤1,75	0,01..4,0

Корпус ТЛВШ.432269.010 с диапазоном частот до 4 ГГц



Габаритный чертеж

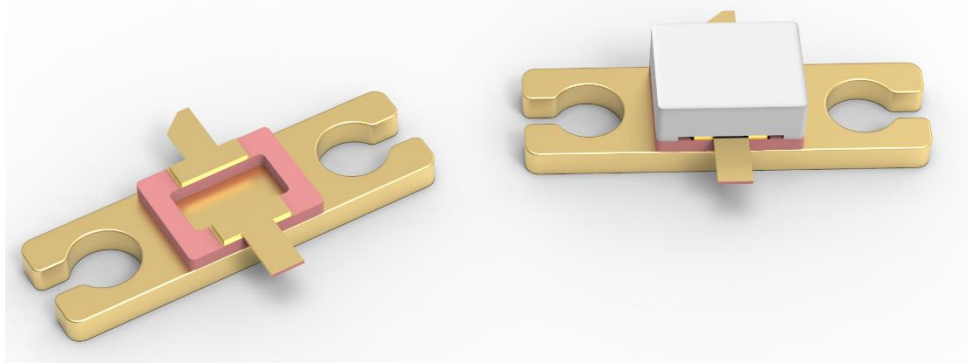


*Размеры до нанесения клея.

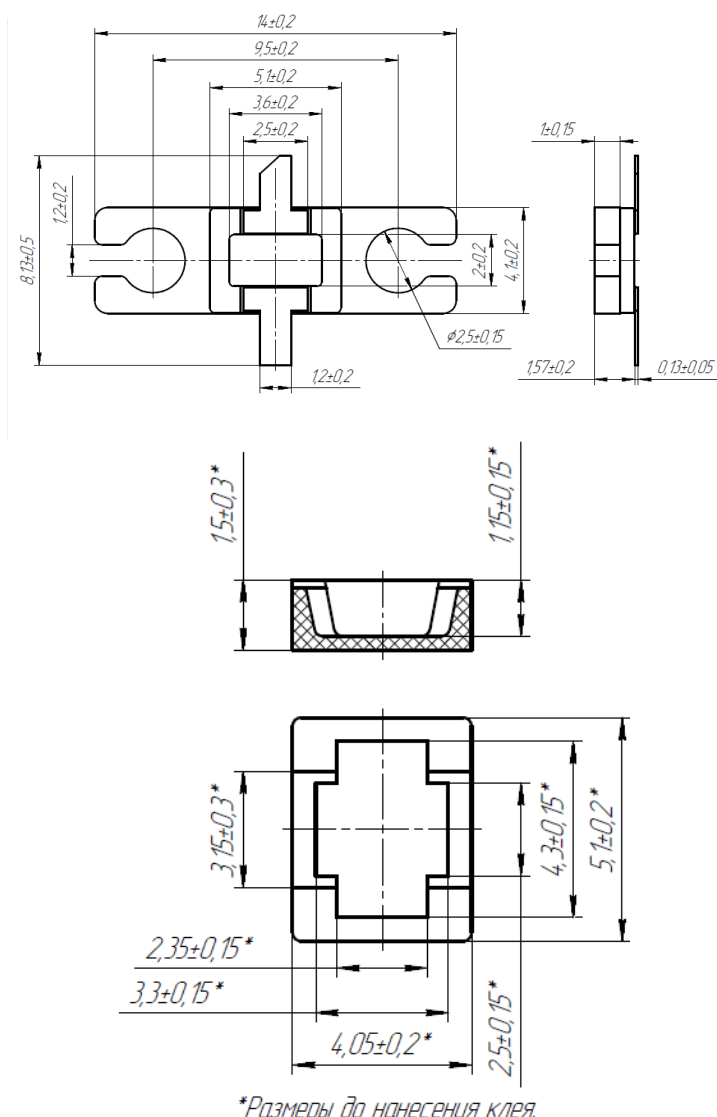
Технические характеристики

Количество выводов, шт.	2
Шаг выводов, мм	-
Размеры основания, мм	20,3×9,9
Высота корпуса с установленной крышкой, мм, не более	4,2
Размер монтажной площадки, мм	16,5×6,1
Покрытие	H3.3л2,5
Метод крепления кристалла в корпусе	клей, пайка
Метод герметизации	клей
Показатель герметичности корпуса, Па·см ³ /с, не более	6,65·10 ⁻³
Диапазон рабочих частот, ГГц, KCB≤1,75	0,01..4,0

Корпус ТЛВШ.432269.012 с диапазоном частот до 6 ГГц



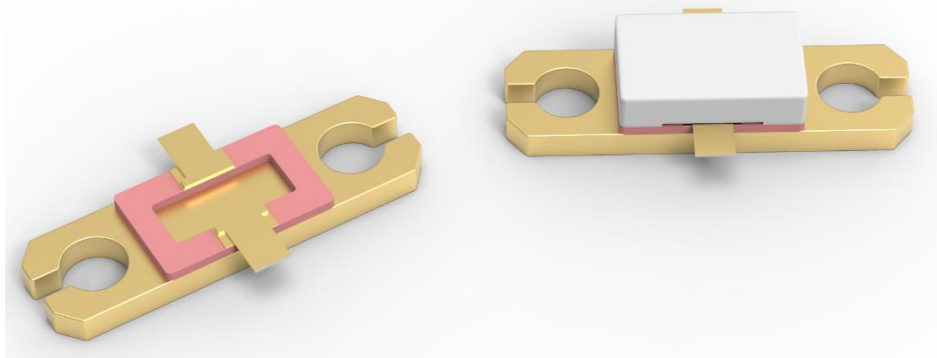
Габаритный чертеж



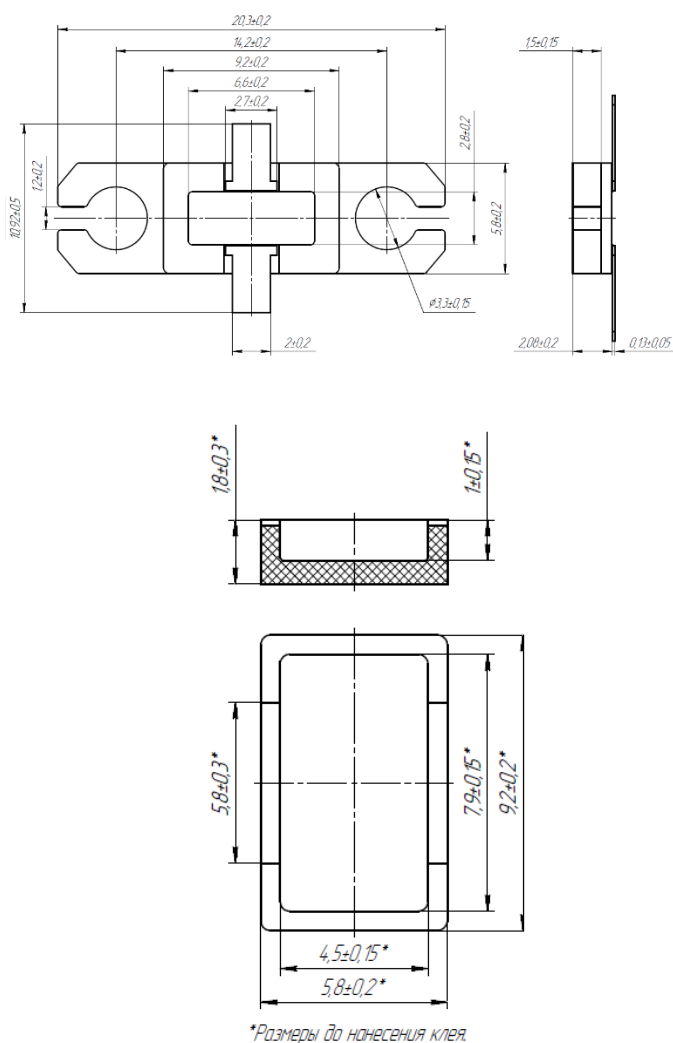
Технические характеристики

Количество выводов, шт.	2
Шаг выводов, мм	-
Размеры основания, мм	14,0×4,1
Высота корпуса с установленной крышкой, мм, не более	4,0
Размер монтажной площадки, мм	3,6×2,0
Покрытие	НЗ.Зл2,5
Метод крепления кристалла в корпусе	клей, пайка
Метод герметизации	клей
Показатель герметичности корпуса, Па·см ³ /с, не более	$6,65 \cdot 10^{-3}$
Диапазон рабочих частот, ГГц, КСВ≤1,75	0,01..6,0

Корпус ТЛВШ.432269.013 с диапазоном частот до 6 ГГц



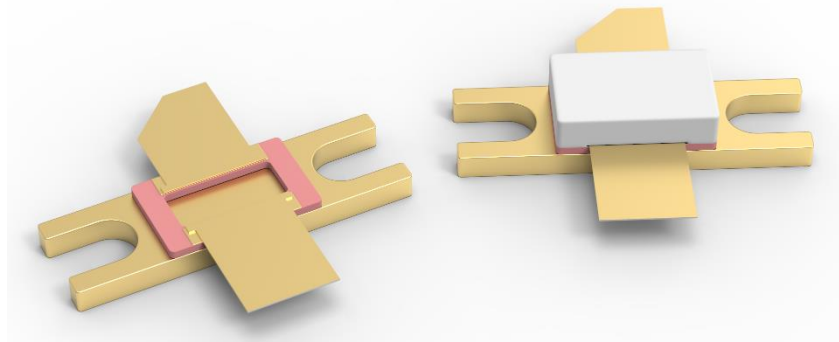
Габаритный чертеж



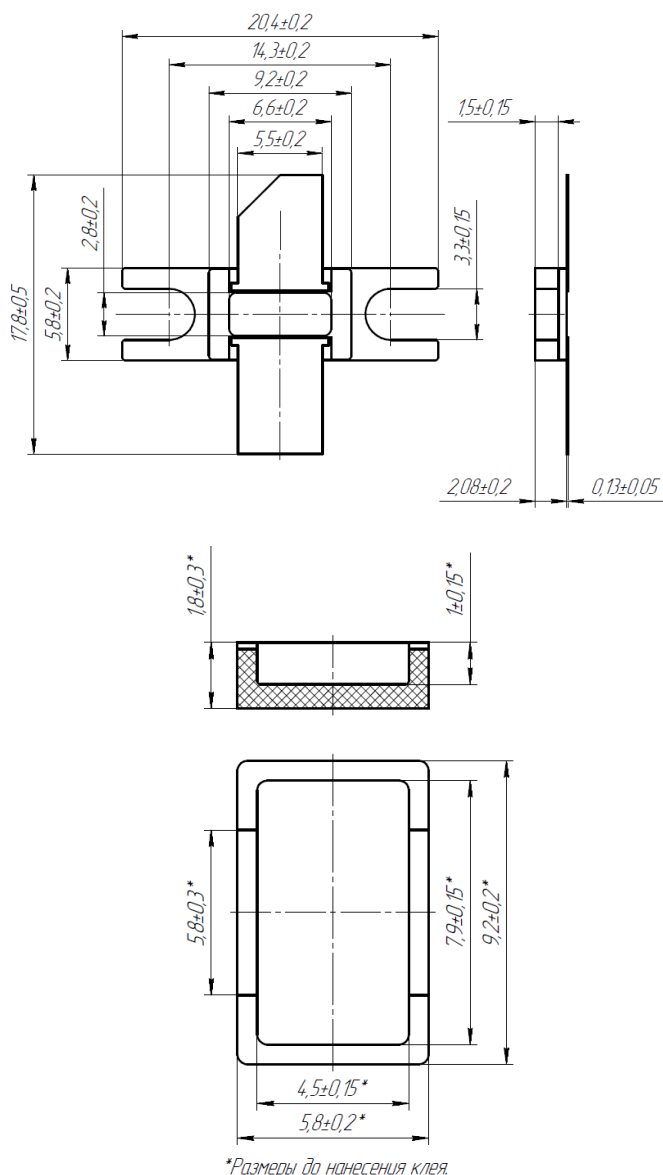
Технические характеристики

Количество выводов, шт.	2
Шаг выводов, мм	-
Размеры основания, мм	20,3×5,8
Высота корпуса с установленной крышкой, мм, не более	4,5
Размер монтажной площадки, мм	6,6×2,8
Покрытие	НЗ.Зл2,5
Метод крепления кристалла в корпусе	клей, пайка
Метод герметизации	клей
Показатель герметичности корпуса, Па·см ³ /с, не более	6,65·10 ⁻³
Диапазон рабочих частот, ГГц, КСВ≤1,75	0,01..6,0

Корпус ТЛВШ.432269.014 с диапазоном частот до 4 ГГц



Габаритный чертеж

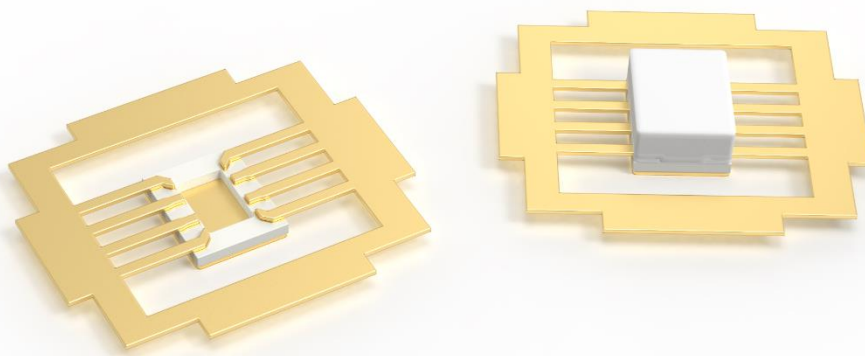


Технические характеристики

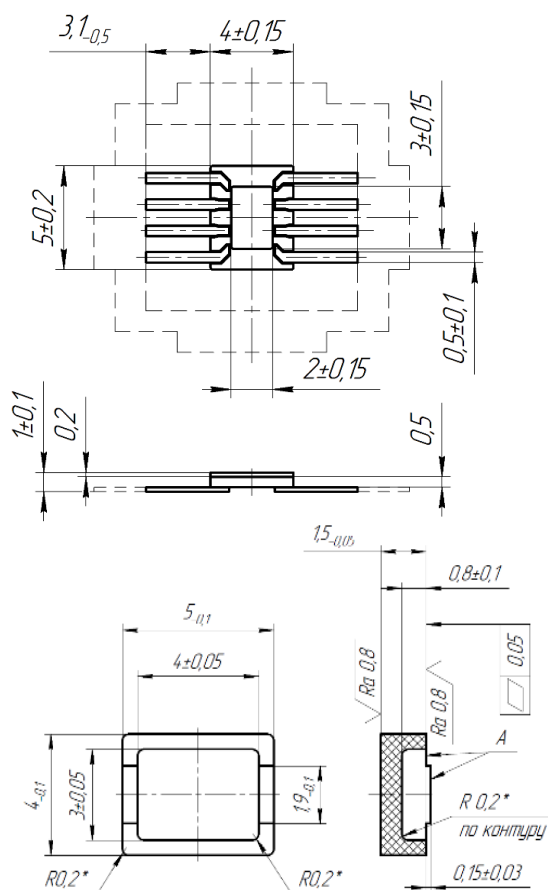
Количество выводов, шт.	2
Шаг выводов, мм	-
Размеры основания, мм	20,4×5,8
Высота корпуса с установленной крышкой, мм, не более	4,5
Размер монтажной площадки, мм	6,6×2,8
Покрытие	НЗ.Зл2,5
Метод крепления кристалла в корпусе	клей, пайка
Метод герметизации	клей
Показатель герметичности корпуса, Па·см ³ /с, не более	6,65·10 ⁻³
Диапазон рабочих частот, ГГц, КСВ≤1,75	0,01..4,0

Корпуса для мощных СВЧ МИС и ГИС

Корпус ТЛВШ.301175.004 с диапазоном частот до 7 ГГц



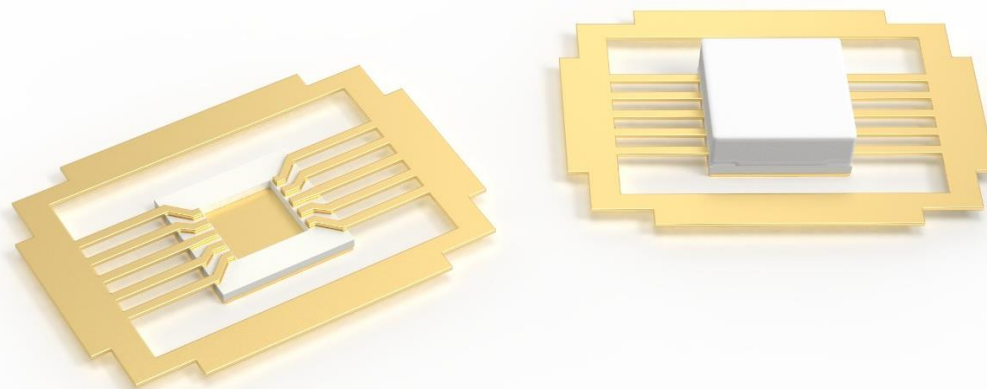
Габаритный чертеж



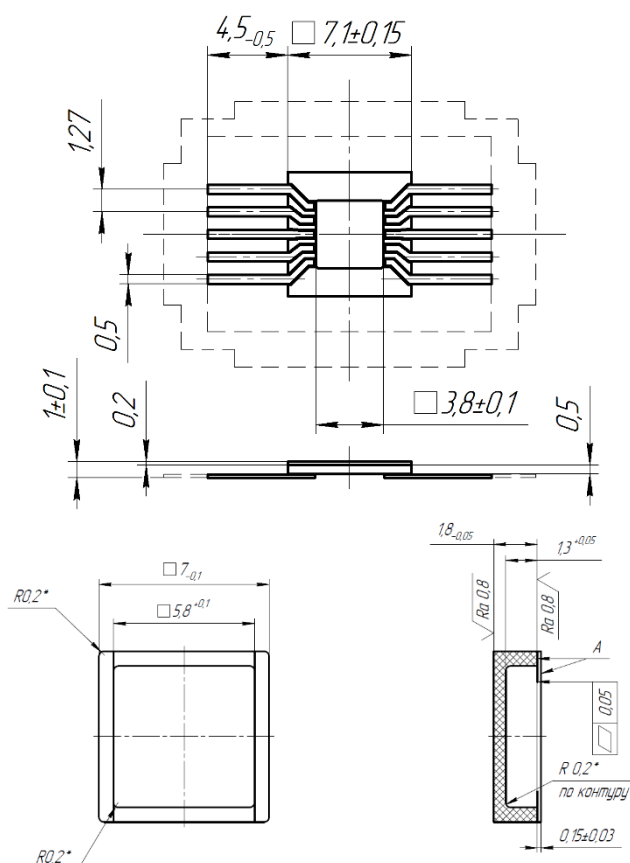
Технические характеристики

Количество выводов, шт.	8
Шаг выводов, мм	1,27
Размеры основания, мм	4,0×5,0
Высота корпуса с установленной крышкой, мм, не более	3,0
Длина выводов, мм, не менее	3,0
Размер монтажной площадки, мм	2,0×3,0
Покрытие	НЗ.Зл4
Метод крепления кристалла в корпусе	клей, пайка
Метод герметизации	клей
Показатель герметичности корпуса, Па·см ³ /с, не более	6,65·10 ⁻³
Диапазон рабочих частот, ГГц, КСВ≤1,75	0,01..7,0

Корпус ТЛВШ.301175.005 с диапазоном частот до 17 ГГц



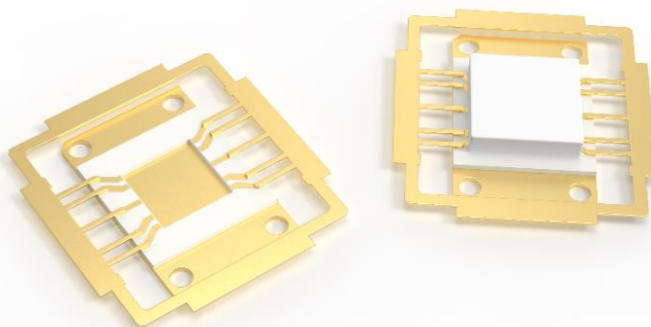
Габаритный чертеж



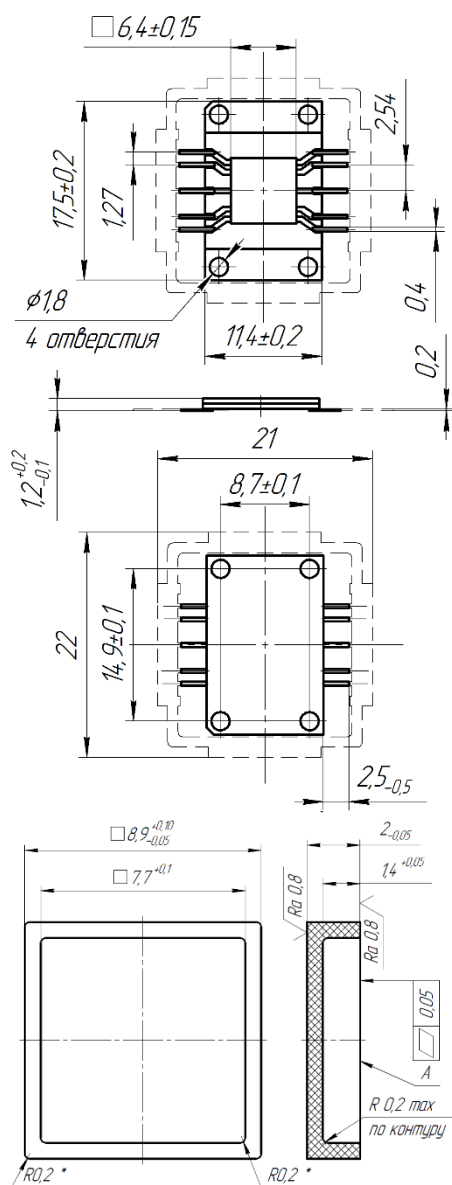
Технические характеристики

Количество выводов, шт.	10
Шаг выводов, мм	1,27
Размеры основания, мм	7,1×7,1
Высота корпуса с установленной крышкой, мм, не более	3,2
Длина выводов, мм, не менее	4,0
Размер монтажной площадки, мм	3,8×3,8
Покрытие	НЗ.Зл4
Метод крепления кристалла в корпусе	клей, пайка
Метод герметизации	клей
Показатель герметичности корпуса, Па·см ³ /с, не более	$6,65 \cdot 10^{-3}$
Диапазон рабочих частот, ГГц, КСВ≤1,75	0,01..17,0

Корпус ТЛВШ.301175.006 с диапазоном частот до 18 ГГц



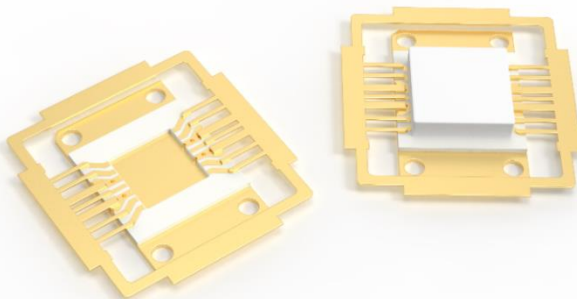
Габаритный чертеж



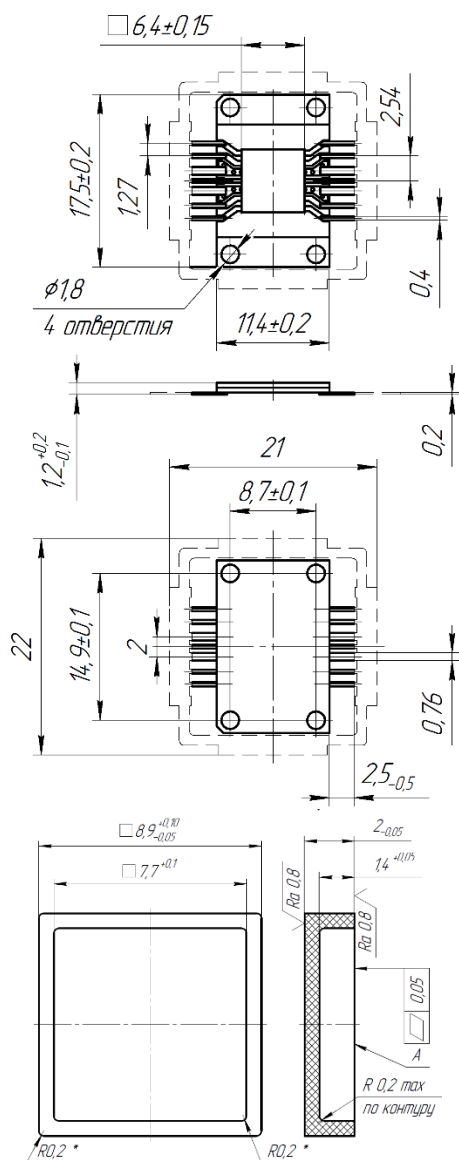
Технические характеристики

Количество выводов, шт.	10
Шаг выводов, мм	-
Размеры основания, мм	17,5×11,4
Высота корпуса с установленной крышкой, мм, не более	4,0
Длина выводов, мм, не менее	2
Размер монтажной площадки, мм	6,4×6,4
Покрытие	НЗ.Зл4
Метод крепления кристалла в корпусе	клей, пайка
Метод герметизации	клей
Показатель герметичности корпуса, Па·см ³ /с, не более	6,65·10 ⁻³
Диапазон рабочих частот, ГГц, КСВ≤1,75	0,01..18,0

Корпус ТЛВШ.301175.007 с диапазоном частот до 18 ГГц



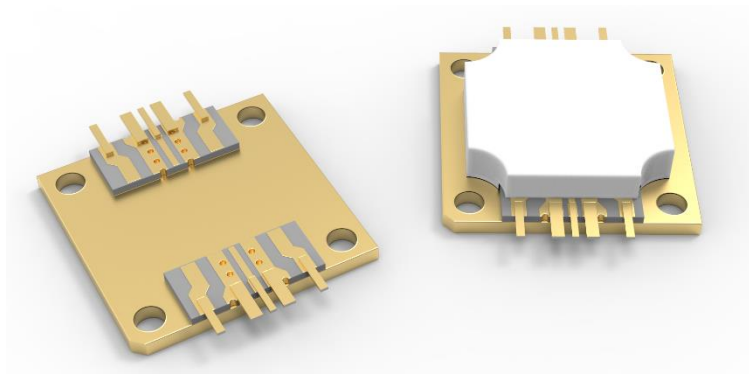
Габаритный чертеж



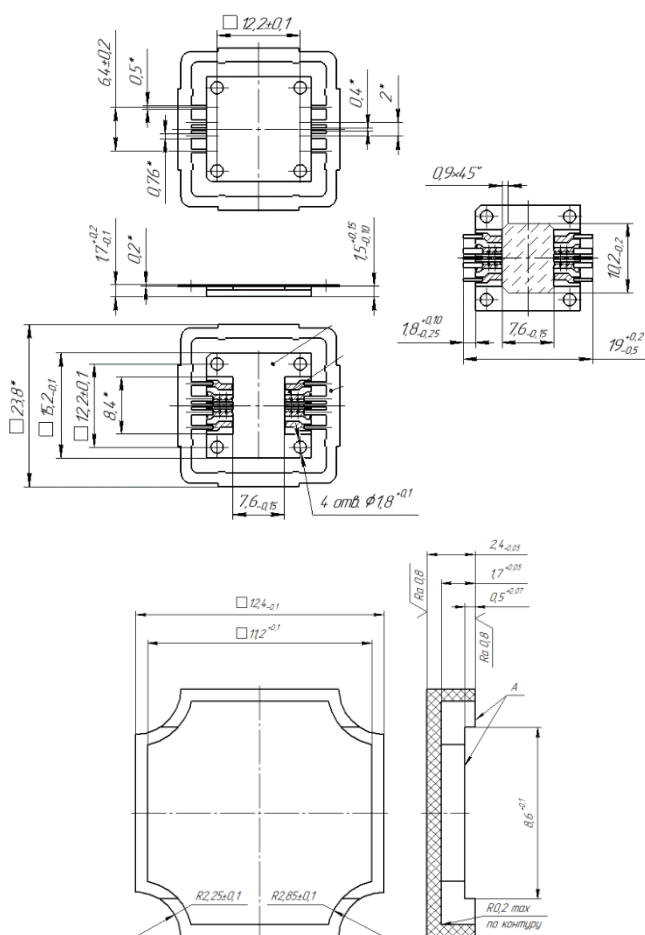
Технические характеристики

Количество выводов, шт.	14
Шаг выводов, мм	-
Размеры основания, мм	17,5×11,4
Высота корпуса с установленной крышкой, мм, не более	4,0
Длина выводов, мм, не менее	2,0
Размер монтажной площадки, мм	6,4×6,4
Покрытие	H3.3л4
Метод крепления кристалла в корпусе	клей, пайка
Метод герметизации	клей
Показатель герметичности корпуса, Па·см ³ /с, не более	6,65·10 ⁻³
Диапазон рабочих частот, ГГц, КСВ≤1,75	0,01..18,0

Корпус ТЛВШ.301175.008 с диапазоном частот до 20 ГГц



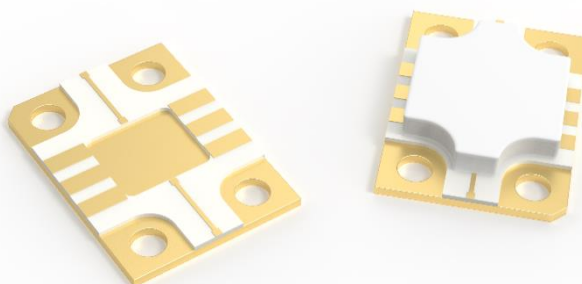
Габаритный чертеж



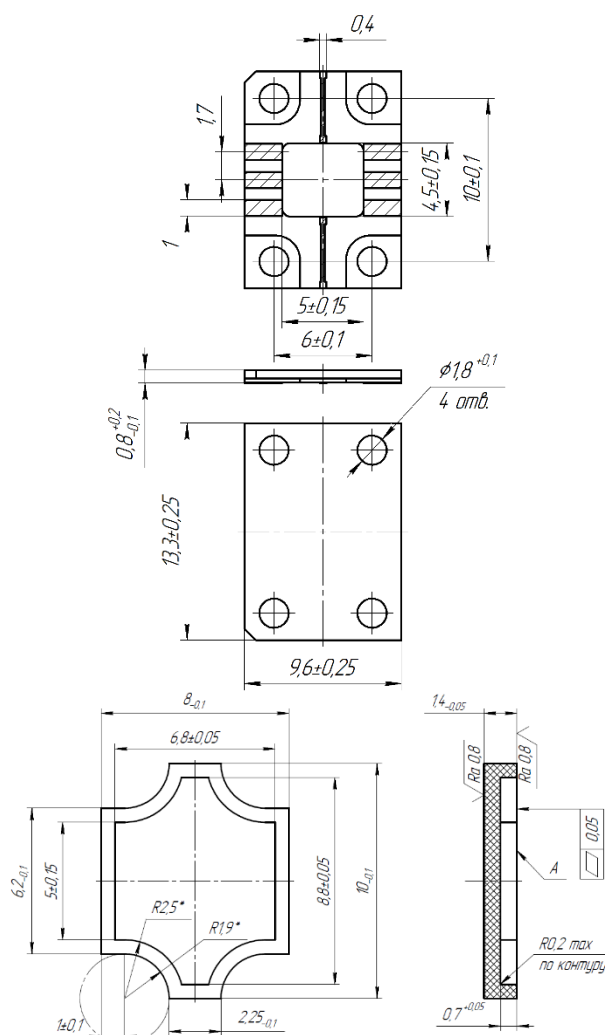
Технические характеристики

Количество выводов, шт.	10
Шаг выводов, мм	-
Размеры основания, мм	15,2×15,2
Высота корпуса с установленной крышкой, мм, не более	5,0
Длина выводов, мм, не менее	1,5
Размер монтажной площадки, мм	7,6×10,2
Покрытие	НЗ.Зл4
Метод крепления кристалла в корпусе	клей, пайка
Метод герметизации	клей
Показатель герметичности корпуса, Па·см ³ /с, не более	6,65·10 ⁻³
Диапазон рабочих частот, ГГц, КСВ≤1,75	0,01..20,0

Корпус ТЛВШ.301175.009 с диапазоном частот до 22 ГГц



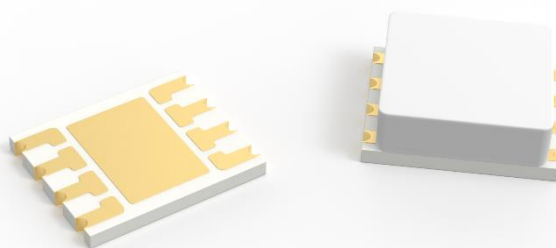
Габаритный чертеж



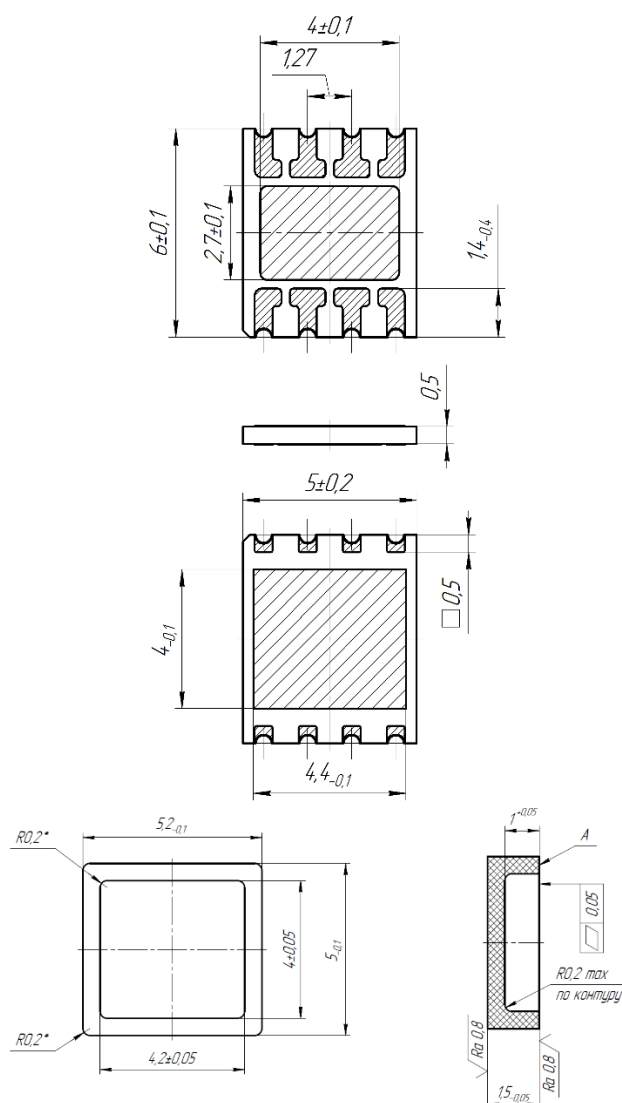
Технические характеристики

Количество выводов, шт.	8
Шаг выводов, мм	1,7
Размеры основания, мм	13,3×9,6
Высота корпуса с установленной крышкой, мм, не более	2,5
Размер монтажной площадки, мм	5×4,5
Покрытие	НЗ.Зл4
Метод крепления кристалла в корпусе	клей, пайка
Метод герметизации	клей
Показатель герметичности корпуса, Па·см ³ /с, не более	6,65·10 ⁻³
Диапазон рабочих частот, ГГц, КСВ≤1,75	0,01..22,0

Корпус ТЛВШ.301175.010 с диапазоном частот до 20 ГГц



Габаритный чертеж



Технические характеристики

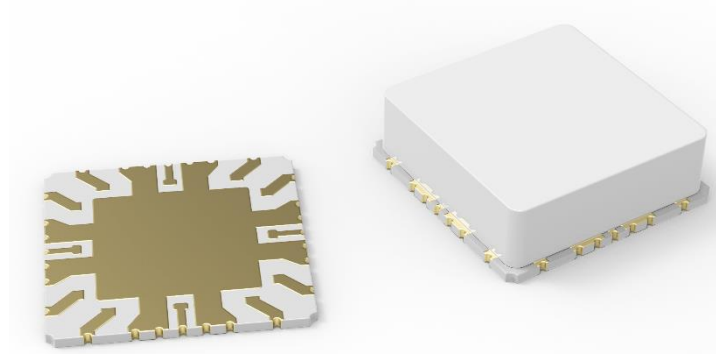
Количество выводов, шт.	8
Шаг выводов, мм	1,27
Размеры основания, мм	6,0x5,0
Высота корпуса с установленной крышкой, мм, не более	3,0
Размер монтажной площадки, мм	4,0x2,7
Покрытие	H3.3л4
Метод крепления кристалла в корпусе	клей, пайка
Метод герметизации	клей
Показатель герметичности корпуса, Па·см ³ /с, не более	6,65·10 ⁻³
Диапазон рабочих частот, ГГц, КСВ≤1,75	0,01..20,0

Варианты исполнения:

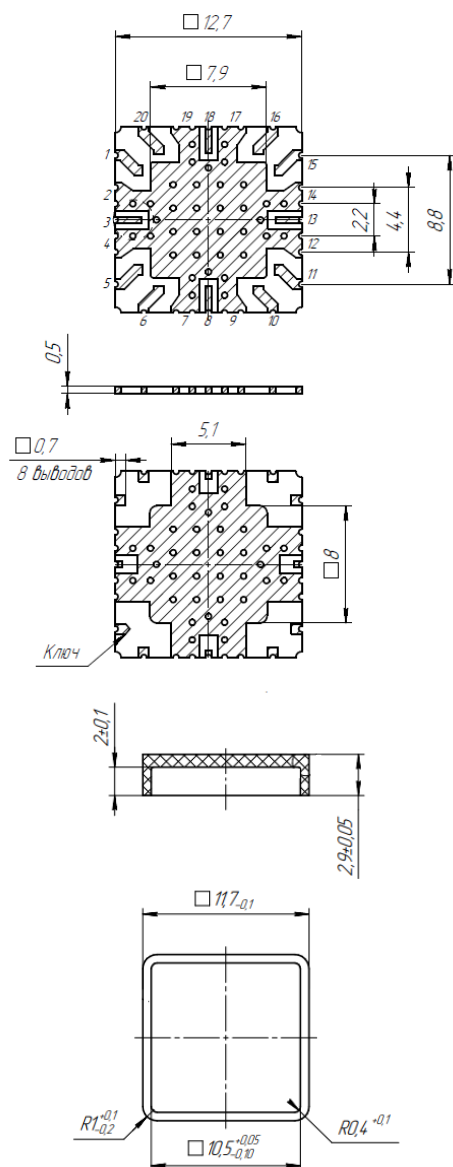
Корпус ТЛВШ.301175.010
– материал основания
ALN-170

Корпус
ТЛВШ.301175.010-01 –
материал основания
Al₂O₃ 99,6%

Корпус ТЛВШ.432269.011 с диапазоном частот до 18 ГГц



Габаритный чертеж



Технические характеристики

Количество выводов, шт	20
Шаг выводов, мм	-
Размеры основания, мм	12,7×12,7
Высота корпуса с установленной крышкой, мм, не более	4,5
Размер монтажной площадки, мм	8,0×8,0
Покрытие	НЗ.3л4
Метод крепления кристалла в корпусе	клей, пайка
Метод герметизации	клей
Показатель герметичности корпуса, Па·см ³ /с, не более	6,65·10 ⁻³
Диапазон рабочих частот, ГГц, КСВ≤1,75	0,01..18,0